

## SE 2260 有機矽灌封膠

### 產品特點

- 雙組分，1:1 加成型導熱灌封膠
- 低黏度，高流動性
- 適當的導熱率
- 優異的電器絕緣性
- 室溫固化或者加熱快速固化

### 產品用途

WANICONE® SE 2260 是一款雙組分加成型導熱灌封膠，室溫固化、加熱可加速固化。該產品具有低黏度、高流動性、適當的導熱率，適合於工作狀態下發熱的電子元器件的灌封和保護。

- 功率模塊、燈座、開關電源
- 轉換器、逆變氣、傳感器、新能源汽車、光伏太陽能
- 電子控制單元

### 性能參數

項目	指標	單位
固化前	A 組分 顏色	白色
	A 組分 黏度	3800
	B 組分 顏色	黑色
	B 組分 黏度	3500
混合固化	混合黏度 (25°C)	3600
	工作時間 (25°C)	75
	固化時間 (25°C)	8-24
	固化時間 (60°C)	60
	密度	1.6
	硬度	54
	導熱率	0.7
	體積電阻率	$8.0 \times 10^{14}$
	極穿電壓	23
	介電常數(50HZ)	2.7

## 包裝規格

WANICONE® SE 2260A: 25kg/桶

WANICONE® SE 2260B: 25kg/桶

## 貯存條件和保質期

請儲存於陰涼、乾燥、通風處。自生產之日起，未開封的 WANICONE® SE 2260 在 30 °C 以下的保質期為 12 個月。

### 使用方法

#### ➤ 表面處理

基材表面需乾燥、清潔，去除銹跡、灰塵和油污等。可使用的清洗溶劑包括酒精、丙酮等。

#### ➤ 施膠

確認兩個組分按照質量比 1:1 混合，建議混合之後真空脫泡。

按照推薦比例混合後，在室溫下 75 分鐘後黏度將翻倍。混合後儘快施膠。

操作時盡量避免帶入空氣，對複雜外形的線路板建議真空灌封。

室溫固化，或高溫加速固化。

未經混合的灌封膠一但包裝開封後，建議儘早使用完畢。如有剩餘，需密閉儲存，儘量減少與空氣中水分的接觸。

## 使用注意事項

➤ 儲存期間可能會產生粉料沉降。因此使用時要將底部攪起，與上層浮油混合均勻。

➤ 混合後的矽膠在 25°C 下只有大約 75 分鐘的操作時間。超過 75 分鐘，矽膠黏度翻倍甚至固化，導致無法灌封。

➤ 不同溫度下，矽膠完全固化時間有較大差異：

➤ 溫度 (°C)	➤ 固化時間
➤ 10	➤ 2-3 day
➤ 25	➤ 8-24 hr
➤ 50	➤ 60 min

➤ 在使用過程中，特別注意不要和以下物質接觸，否則會導致產品固化不完全或者甚至不固化。比如：含有機錫的物質、含硫的物質、氨基、聚氨酯、酰胺及疊氮化物。

## 環境健康

有關安全環保方面的信息，請參閱我公司產品的安全數據說明書或與我公司客戶服務中心聯繫。

本資料所給出的指標、數據乃基於我們現有的技術知識水平和實踐經驗，僅供參考。具體保證指標以 SE 2260 有機矽灌封膠 3 / 3 萬華化學集團股份有限公司質量保證書或供貨合同規定為準。用戶對於所購買我公司的產品有責任進行試驗，以驗證是否適合各自所擬定的工藝和用途，並達到預定的目的。對我公司產品的進一步應用和加工均非我公司所能控制，因此，我們對所提供的產品的責任範圍只限於我方交付且為貴方所使用的部分。而不承擔在採用我公司產品為原料進行生產過程中而造成的間接損失。我公司市場部技術支持與客戶服務中心願為您提供有關產品的諮詢與應用技術服務，歡迎來函聯電聯繫。

聯繫地址：山東省煙臺市經濟技術開發區天山路 17 號 郵編：264006

客戶服務中心諮詢電話：+86 (535)-8203244 傳真：+86 (535)-3388222-3244

<http://www.whchem.com> E-mail：PCS@whchem.com